

行业点评

华虹22Q4毛利率创新高，产能利用率虽下滑但仍满载

强于大市（维持）

行情走势图



证券分析师

付强 投资咨询资格编号
S1060520070001
FUQIANG021@pingan.com.cn

徐勇 投资咨询资格编号
S1060519090004
XUYONG318@pingan.com.cn

研究助理

徐碧云 一般证券从业资格编号
S1060121070070
XUBIYUN372@pingan.com.cn



事项：

华虹半导体发布2022年四季报，公司2022年第四季度单季度实现营业收入6.30亿美元，同比增长19.3%；实现归母净利润1.59亿美元，同比增长19.2%。

平安观点：

- **毛利率创新高，产能利用率继续下滑但仍满载：**公司四季度单季度营收仍保持在6.30亿美元，同比增长19.3%，环比持平，与上季度的指引一致；归母净利润为1.59亿美元，同比增长19.2%，环比增长53.2%；毛利率为38.2%，高于此前的指引区间（35%-37%），同比提升5.7pct，环比提升1.0pct，创下新高，主要是在保证产能利用率的前提下，不断优化产品组合，产品ASP持续提升带来的；净利润率达到了29.5%，同比提升3.5pct，环比提升19.1pct；净资产收益率（年化）达到22%，同比提升2.8pct，环比提升7.6pct；整体的产能利用率103.2%，维持满产，但同比下降2.2pct，环比下降7.6pct；交付晶圆（折合8吋）992K片，同比下降2.9%，环比下降1.1%；四季度资本开支3.311亿美元，其中3.109亿美元用于无锡12吋厂。分8吋和12吋来看，8吋厂实现营收3.975亿美元（+23.2%YOY），营收占比为63.1%，产能利用率达105.9%（-1.6pct YOY，-7.5pct QOQ）；12吋厂实现营收2.326亿美元（+13.1%YOY），营收占比为36.9%，产能利用率达99.9%（-2.6pct YOY，-7.8pct QOQ），产能利用率继续下滑。2022年全年，公司营收达到24.76亿美元，同比增长51.8%；全年毛利率34.1%，同比提升6.4pct；净资产收益率15.2%；产能利用率达到107.4%。
- **MCU、智能卡芯片与CIS等逻辑需求分化明显：**从技术平台来看，2022年Q4，嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、分立器件、逻辑及射频、模拟与电源管理营收占比分别为37.5%、5.8%、33.8%、6.8%、16.0%，逻辑与射频营收同比下滑49.5%（主要系CIS等逻辑产品的需求减少），占比从22Q1的16%持续下降至22Q4的6.8%，而嵌入式非易失性存储器22Q4营收同比增长75.7%，占比从22Q1的23.9%持续提升至22Q4的37.5%（主要系MCU、智能卡芯片的需求增加）。从工艺技术节点来看，55nm及65nm、90nm及95nm、0.11μm及0.13μm、0.15μm及0.18μm、0.25μm、0.35μm及以上营收占比分别为9.4%、19.8%、20.0%、8.9%、0.7%、41.2%。其中55nm及65nm营收同比下降了20.5%，营收占比环比继续下降，主要是逻辑及CIS的需求减少；而0.11μm及0.13μm制程营收同比增长了49.4%，主要是MCU的需求增加。
- **工业与汽车增长态势向好，预计2023Q1毛利率或将下降：**从终端市场来

看，营收占比最大的依然是电子消费品（62.1%），其次是工业与汽车（26.9%）、通讯（8.0%）、计算机（3.0%），其中消费电子同比增长12%，主要是MCU、超级结、智能卡芯片增加，部分抵消了逻辑产品的减少；通讯同比下降16%，主要是CIS需求减少，抵消了智能卡芯片的需求增加；而工业与汽车继续保持了同比增长69.7%的态势，主要是MCU、IGBT、其他电源管理和智能卡芯片需求增加。业绩指引方面，公司预计2023年Q1营收仍保持在6.30亿美元，毛利率预计降至32%~34%，主要是受到12吋产能扩张带来的折旧费用、晶圆厂年度维护费用以及年终奖计提等因素的综合影响。公司将继续强化在特色工艺领域的优势，持续优化8吋平台，12吋平台继续进行技术升级和产能扩张。12英寸第二阶段扩产的七八成设备已到位，2023年Q3至Q4将释放产能至9.5万片，同时将适时启动12吋新厂建设。近期公司拟募资180亿元进行科创板IPO，其中华虹制造（无锡）项目125亿元、8英寸厂优化升级项目20亿元、特色工艺技术创新研发项目25亿元，将有助于华虹进一步扩大产能规模，丰富工艺平台，从而提升在晶圆代工行业的市场地位和核心竞争力。

- **投资建议：**当前CIS、逻辑等的下游消费电子、通讯、计算机市场需求依然疲软，而汽车、工业等市场需求仍然向好，包括新能源汽车、新能源发电、工业自动化等，建议关注相关赛道和业务已经取得突破的公司。功率半导体方面，推荐时代电气、斯达半导、新洁能，建议关注东微半导；模拟方面，推荐纳芯微；MCU和智能卡方面，推荐兆易创新，建议关注复旦微电。
- **风险提示：**1）宏观经济波动和行业周期性的风险：如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，消费电子等下游市场需求的波动和低迷亦会导致半导体产品的需求下降，半导体上市公司收入和业绩增长可能不及预期。2）国际贸易摩擦的风险上升。中美关系的不确定性较高，美国对中国科技产业的打压加剧，半导体产业对全球尤其是美国科技产业链的依赖依然严重，被“卡脖子”的风险依然较高。3）政策支持力度不及预期。半导体产业正处在发展的关键时期，很多领域在国内处于起步阶段，离不开政府政策的引导和扶持，如果后续政策落地不及预期，行业发展可能面临困难。4）国产替代不及预期。如果客户认证周期过长，国内厂商的产品研发技术水平达不到要求，则可能影响国产替代的进程。

平安证券研究所投资评级:

股票投资评级:

- 强烈推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现20%以上）
- 推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现10%至20%之间）
- 中性（预计6个月内，股价表现相对市场表现在±10%之间）
- 回避（预计6个月内，股价表现弱于市场表现10%以上）

行业投资评级:

- 强于大市（预计6个月内，行业指数表现强于市场表现5%以上）
- 中性（预计6个月内，行业指数表现相对市场表现在±5%之间）
- 弱于大市（预计6个月内，行业指数表现弱于市场表现5%以上）

公司声明及风险提示:

负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的，本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款:

此报告旨为发给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券股份有限公司2023版权所有。保留一切权利。



平安证券研究所			电话:4008866338
深圳	上海	北京	
深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座25层 邮编:518033	上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼 邮编:200120	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16层 邮编:100033	